

ウェットコーティングの 単層および重層塗布技術解説と塗布故障の原因と対策

LIVE配信
アーカイブ配信
7日間視聴可能

★日時：2026年1月29日（木）13:00～17:00

★会場：WEB受講のみ（Zoomシステム）

※LIVE配信／アーカイブ配信（7日間視聴可能）

★受講料：1名 44,000円（消費税込）

同一セミナー同一企業同時複数人数申込みの場合 1名38,500円

★受講資料：PDF資料（受講料に含む）

ウェットコーティングの理論と実践を体系的に学び、濡れ性・表面張力・膜厚均一化の基礎から、単層・重層各方式の特徴、リバースロール／グラビヤ／ダイ／バー塗布の現象解析、さらには特許動向や塗布故障対策までを総合的に習得できます。
歩留まりを左右する「塗布ムラ・ハジキ・膜厚不良」を科学的に解析し、単層／多層コーティングの原理・方式・トラブル対策ノウハウを学べる特別セミナー！！

【講師の言葉】 機能性フィルムを安価に生産するために、ウェットコーティング技術を適用することが多い。ウェットコーティングにおいて、特に水系塗布液の場合、塗布液が支持体に塗り付く濡れ性が重要なため、まず表面張力について説明する
塗布方式については、塗布量、塗布速度、塗布液粘度により多くの方式が用いられているが、今回はリバースロール塗布方式、ダイ塗布方式、グラビヤ塗布方式、バー塗布方式、ウェブテンションドなど5方式の特徴について解説するとともに、同時多層塗布方式についても説明する。
また、塗布品の品質として塗布の厚み精度が重要であり、ダイ塗布方式による厚み変動要因について解説するとともに、ダイ塗布方式およびバー塗布方式による注目する特許について解説する。
最後に塗布故障として、ハジキ、パーティクル異常、塗布膜厚異常の現象と故障解析方法について解説する。

【受講形式】 WEB受講のみ ※本セミナーは、Zoomシステムを利用したオンライン配信となります。

【予備知識】 特に必要ありません。

【受講対象】 1. 実際のウェットコーティングの製造に携わっている人 2. ウェットコーティング設備を計画している人
3. ウェットコーティングの設備開発に携わっている人 4. 製品のコストダウンに携わっている人

【習得知識】 1) 濡れ性、表面張力、フィルム濡れ性の測定方法 2) 前計量、後計量方式と特徴
3) 「塗布技術」としての内容 4) 各種塗布（単層と同時重層）方式(計7方式)の特徴理解
5) ダイ・バー等の特徴。またリバースロール、リバースグラビヤ塗布方式の現象論の詳細
6) ウェブテンションドダイ塗布方式の特徴 7) ダイによる膜厚均一化の知識 8) ダイ塗布方式の特許知識
9) バー塗布の最新特許技術 10) 塗布故障解析の解析方法 11) 塗布故障事例を通して故障解析の手法、考え方

【講師】 CNコンサルティング事務所 所長 千野 直義 先生 元 富士フィルム（株）

1. ウェットコーティング現象の基礎

1.1 濡れ性 1.2 塗布界面
1.3 支持体と塗布液の表面張力の関係

2. 塗布技術の内容

2.1 塗布操作の基本 2.2 前計量と後計量
2.3 塗布技術開発とコストの関係
2.3.1 広幅化 2.3.2 塗布高速化
2.3.3 薄層塗布化 2.3.4 均一化他

3. 代表的な単層塗布技術

3.1 リバースロールコーティング 理論的解析紹介含む
3.2 グラビヤコーティング リバースグラビヤ塗布の詳細現象含む
3.3 ワイヤバーコーティング 3.4 ダイコーティング
3.5 ウェブテンションドダイ(究極の高速薄層塗布方式)

4. 代表的な重層塗布方式

4.1 スライドホッパーコーティング
4.2 ウェブテンションドダイコーティング

5. ダイ塗布方式における塗布膜厚分布の要因

5.1 給液とマニホールド要因 5.2 スロット精度要因
5.3 設置精度要因

6. ダイリップ先端形状と段差と塗布への影響

6.1 ダイ先端形状と塗布性 6.2 ダイ先端段差と塗布性

7. ダイ塗布方式における注目の特許

7.1 特許出願メーカー 7.2 幅方向の膜厚の均一化に関する特許
7.3 ダイ先端エッジ形状に関する特許
7.4 バキュームに関する特許 7.5 間欠塗布に関する特許

8. ワイヤバーにおける注目の特許技術

8.1 バー塗布の基本特許、及び技術課題
8.2 リブスジ対策に関する特許
8.3 塗り付けの安定化に関する特許
8.4 塗布端部の安定化に関する特許
8.5 精密バーに関する特許

9. 塗布故障の原因と対策の実例

9.1 一般的な塗布故障と原因 9.2 ハジキ故障 2例紹介
9.3 乾燥炉内パーティクル異常解析と原因対策
9.4 塗布液温による膜厚分布故障

質疑・応答

◆セミナーお申込要領

- ・弊社ホームページの申込欄又は、E-mailかFAXにてお申し込みください。
- ・受付後、受講票・請求書等をメールで送信します。
- ・開催日の8日前以内のキャンセルの場合、受講料の全額を申し受けます。

◆申込書：2026年1月29日：セミナー

会社名： 部署名：
住所：
TEL： FAX：
氏名：
Email：

◆申込先



TH企画セミナーセンター



株式会社TH企画

〒108-0014 東京都港区芝4丁目5-11 芝プラザビル5F

TEL: 03-6435-1138

FAX: 03-6435-3685

Email: th@thplan.com

URL: <https://www.thplan.com/>

詳細、その他のセミナーは、ホームページをご覧ください。

検索

TH企画



サイト内
キーワード検索

0129
(開催日)